

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 3 区分
 【発行日】平成 17 年 6 月 2 日 (2005.6.2)

【公開番号】特開 2003-6587 (P2003-6587A)
 【公開日】平成 15 年 1 月 10 日 (2003.1.10)
 【出願番号】特願 2001-184836 (P2001-184836)
 【国際特許分類第 7 版】

G 0 6 K 19/07
 B 4 2 D 15/10
 G 0 6 K 19/077

【F I】

G 0 6 K 19/00 H
 B 4 2 D 15/10 5 2 1
 G 0 6 K 19/00 K

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 8 月 13 日 (2004.8.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

半導体部品の裏面に該半導体部品の補強を行う第 1 半導体部品補強部材を接触させて設け、

上記半導体部品及び上記第 1 半導体部品補強部材が接触した状態にて、当該半導体部品及び第 1 半導体部品補強部材と第 1 基材とを相対的に押圧し、上記半導体部品及び上記第 1 半導体部品補強部材を上記第 1 基材内へ埋設する、
 ことを特徴とする半導体部品実装済部品の製造方法。

【請求項 2】

上記埋設動作後、上記裏面に対向する上記半導体部品のアクティブ面に形成されている電極部が露出している上記第 1 基材の回路形成面に、上記電極部に接触して回路パターンを形成する、請求項 1 記載の半導体部品実装済部品の製造方法。

【請求項 3】

半導体部品と第 1 基材とを相対的に押圧して上記半導体部品を上記第 1 基材内へ埋設し、

上記半導体部品の補強を行う第 1 半導体部品補強部材が予め埋設された第 2 基材を、上記第 1 基材内に埋設された上記半導体部品の裏面側であって上記半導体部品と上記第 1 半導体部品補強部材とが重なるように配置し、

上記第 1 基材と上記第 2 基材とを接合し、

上記接合後、上記裏面に対向する上記半導体部品のアクティブ面に形成されている電極部が露出している上記第 1 基材の回路形成面に、導電性ペースト又は金属メッキにて上記電極部に接触して回路パターンを形成する、
 ことを特徴とする半導体部品実装済部品の製造方法。

【請求項 4】

請求項 2 又は 3 記載の半導体部品実装済部品の製造方法にて製造されたことを特徴とする半導体部品実装済部品。

【請求項 5】

請求項 2 又は 3 記載の半導体部品実装済部品の製造方法にて半導体部品実装済部品を製造し、

上記第 1 基材の厚み方向から第 3 基材及び第 4 基材にて上記半導体部品実装済部品のラミネート処理を行う、

ことを特徴とする半導体部品実装済完成品の製造方法。

【請求項 6】

上記第 1 基材の上記回路形成面側に上記第 4 基材が配置されるとき、上記半導体部品に対向して上記第 4 基材には予め第 2 半導体部品補強部材が埋設されている、請求項 5 記載の半導体部品実装済完成品の製造方法。

【請求項 7】

請求項 5 又は 6 記載の半導体部品実装済完成品の製造方法にて製造されたことを特徴とする半導体部品実装済完成品。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

又、上記埋設動作後、上記裏面に対向する上記半導体部品のアクティブ面に形成されている電極部が露出している上記第 1 基材の回路形成面に、上記電極部に接触して回路パターンを形成することもできる。